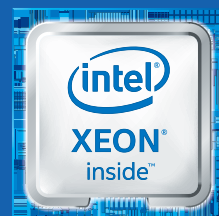


最大22コアのXeon® E5-2600 v4搭載。スリム・ミニタワーながら優れた拡張性

HMV-S612SRM-TY



- インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v4製品ファミリーを搭載
- シングルプロセッサーで、最大22コア (44スレッド)構成
- 最大512GBメモリー (DDR4)搭載可能
- サーバー/ワークステーション/組込み向けチップセット インテル® C612を装備
- 1基のPCI-E (x16)シグナルと2基のPCI-E (x8)シグナルを装備
- スリムな筐体にフルハイトサイズの拡張ボードが可能
- リモート監視を実現するIPMI2.0装備
- 絶縁型32 DIO (16 DI/ 16 DO)を標準搭載
- 信頼性の高い日本製電源を搭載



■製品特長

シングルXeon® プロセッサ E5-2600 v4製品ファミリーとC612チップセット

画像処理・マシンビジョン分野において処理性能を向上させる14nmプロセス世代のCPU、インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 v4製品ファミリーを搭載。シングルプロセッサ構成により最大22コア (44スレッド、Embedded選択時は18コア36スレッド)、最大512GBメモリー (DDR4)まで搭載可能です。またインテル® C612は、サーバーやワークステーション用途だけでなく、組み込み向け用途にも対応しているチップセットで長期供給が可能です。

1基のPCI-E (x16)シグナルと2基のPCI-E (x8)シグナルを装備

1基のPCI Express x16(x16シグナルGen 3.0)と最大2基のPCI Express x8(x8シグナルGen 3.0※標準：空きスロットは1基、DIO拡張ボードで1基使用。)を装備。拡張性に優れ、画像処理・マシンビジョンで利用されるグラフィックスボードやフレームグラバボードなどを搭載することが可能です。

遠隔地からのリモート監視・制御を可能にするIPMIを搭載

ネットワークを通じて、遠隔地からPCの温度・電源・ファンの状態などを監視・制御することができます。

スリムでありながら拡張性に優れたモニター

装置やシステムに組み込みやすいスリムな筐体にフルハイトクラスの拡張ボードを搭載することができます。

動作検証済みのDIOボードを標準搭載

動作検証済みのDIO(デジタル入出力)ボードを標準搭載。手間のかかる動作検証や不具合を気にすることなく、安心してDIOボードを搭載した産業用PCをお使いいただけます。

■製品仕様

プロセッサ	種類	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 v4 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1600 v4
	搭載数	1
チップセット		インテル® C612 チップセット
メモリー	規格	DDR4 2400/2133/1866/1600MHz
	最大容量	512GB
	スロット数	4
ストレージ	5インチベイ	1(空き0) ※標準:ODD×1使用
	3.5インチベイ	3(空き2)(内部2) ※標準:ストレージ×1使用
	SATAコネクタ数	10(空き8)(SATA 3.0) ※標準:ODD×1とストレージ×1で使用
グラフィックス		ASPEED AST2400 BMC
I/O	VGA	1 ※グラフィックスカード搭載およびオンボードRAID使用時、オンボードD-SUB端子からの出力ができません。
	シリアル(COM)	1
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.0), 2 (USB2.0)
	LAN	2 (GbE)
	IPMI	1
	UID	1
	DIO	絶縁型DIO (16 DI, 16 DO) ※拡張ボードにより増設
拡張スロット	PCI Express x16	1 (x16シグナルGen 3.0)
	PCI Express x8	2 (x8シグナルGen 3.0) (空き1) ※標準:DIO拡張ボード×1搭載
外形寸法		W136mm × D386mm × H356mm (突起物等を除く)
重量		約9kg
電源		日本製電源 310W(連続最大容量)/400W(ピーク容量)
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10℃~35℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL: 03-5446-5535 / hpcs_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
2018年6月12日現在の内容です。